



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of: MURAYAMA, Kei, et al.

Group Art Unit: Unassigned

Serial No.: 10/708,957

Examiner: Unassigned

Filed: April 2, 2004

P.T.O. Confirmation No.: 2956

For. PATTERNING APPARATUS AND FILM PATTERNING

CLAIM FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Date: April 5, 2004

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application is hereby requested for the above-identified application, and the priority provided in 35 U.S.C. 119 is hereby claimed:

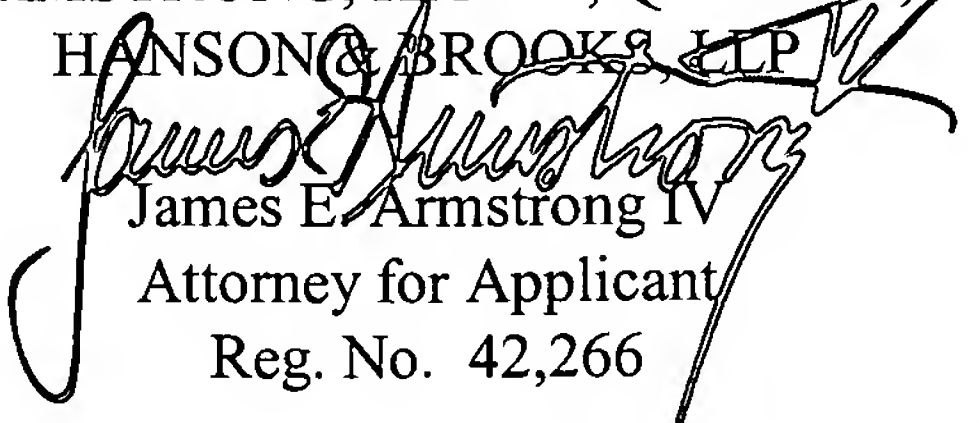
Japanese Appln. No. 2003-115240, filed April 21, 2003

In support of this claim, the requisite certified copy of said original foreign application is filed herewith.

It is requested that the file of this application be marked to indicate that the applicants have complied with the requirements of 35 U.S.C. 119 and that the Patent and Trademark Office kindly acknowledge receipt of said certified copy.

In the event that any fees are due in connection with this paper, please charge our Deposit Account No. 01-2340.

Respectfully submitted,

ARMSTRONG, KRATZ, QUINTOS,
HANSON & BROOKS, LLP

James E. Armstrong IV
Attorney for Applicant
Reg. No. 42,266

JAM/mla
Atty. Docket No. 040137
Suite 1000
1725 K Street, N.W.
Washington, D.C. 20006
(202) 659-2930



23850

PATENT TRADEMARK OFFICE

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

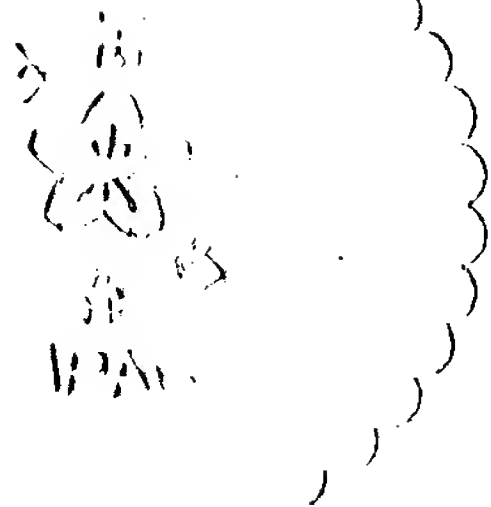
別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2003年 4月21日

出願番号
Application Number: 特願2003-115240
[ST. 10/C]: [JP2003-115240]

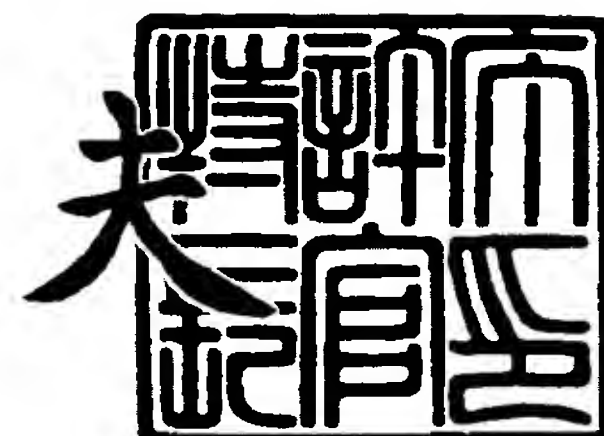
出願人
Applicant(s): 新光電気工業株式会社



2004年 3月11日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 14-335

【提出日】 平成15年 4月21日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H05K 3/00
H05K 3/10

【発明の名称】 パターニング装置及び膜のパターニング方法

【請求項の数】 13

【発明者】

【住所又は居所】 長野県長野市大字栗田字舎利田 7 1 1 番地 新光電気工業株式会社内

【氏名】 村山 啓

【発明者】

【住所又は居所】 長野県長野市大字栗田字舎利田 7 1 1 番地 新光電気工業株式会社内

【氏名】 東 光敏

【発明者】

【住所又は居所】 長野県長野市大字栗田字舎利田 7 1 1 番地 新光電気工業株式会社内

【氏名】 坂口 秀明

【特許出願人】

【識別番号】 000190688

【氏名又は名称】 新光電気工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100091672

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋人形町 3 丁目 1 1 番 7 号
山西ビル 4 階

【弁理士】

【氏名又は名称】 岡本 啓三

【電話番号】 03-3663-2663

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013701

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9816048

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 パターニング装置及び膜のパターニング方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 基板が載置されるステージと、
紫外線と反応して金属が析出する液体を前記基板上に塗布する塗布手段と、
前記基板上に塗布される前記液体に紫外線を照射する紫外線照射手段とを有することを特徴とするパターニング装置。

【請求項 2】 前記液体は、溶媒に金属錯体を溶解したものであることを特徴とする請求項 1 に記載のパターニング装置。

【請求項 3】 前記塗布手段は、バブルジェット方式により前記液体を噴射して塗布することを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載のパターニング装置。

【請求項 4】 前記塗布手段は、 piezo 抵抗効果を利用する piezo 駆動方式により前記液体を噴射して塗布することを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載のパターニング装置。

【請求項 5】 前記ステージには前記基板を加熱する加熱手段が設けられていることを特徴とする請求項 1 乃至 4 のいずれか一項に記載のパターニング装置。

【請求項 6】 前記紫外線の波長は、100 乃至 300 nm であることを特徴とする請求項 1 乃至 5 のいずれか一項に記載のパターニング装置。

【請求項 7】 紫外線と反応して金属が析出する液体を基板上に塗布する工程と、

前記液体を基板上に塗布しながら、又は前記液体を塗布した後に、前記液体に前記紫外線を照射することにより、前記基板上に前記金属を析出させて金属膜パターンを形成する工程とを有することを特徴とする膜のパターニング方法。

【請求項 8】 前記液体は、溶媒に金属錯体を溶解したものであることを特徴とする請求項 7 に記載の膜のパターニング方法。

【請求項 9】 前記金属錯体は、金錯体、銅錯体、パラジウム錯体及びニッケル錯体のいずれかであることを特徴とする請求項 8 に記載の膜のパターニング方法。

【請求項 1 0】 前記金属錯体は、シアン化金を含むことを特徴とする請求項 8 に記載の膜のパターニング方法。

【請求項 1 1】 前記金属膜パターンを形成する工程において、前記基板を加熱した状態で行うことを特徴とする請求項 7 乃至 1 0 のいずれか一項に記載の膜のパターニング方法。

【請求項 1 2】 前記金属膜パターンを形成する工程において、前記紫外線の照射量を調整することにより、前記金属膜パターンの膜厚を制御することを特徴とする請求項 7 乃至 1 1 のいずれか一項に記載の膜のパターニング方法。

【請求項 1 3】 前記液体を基板上に塗布する工程において、インクジェット法により行われることを特徴とする請求項 7 乃至 1 2 のいずれか一項に記載の膜のパターニング方法。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明はパターニング装置及び膜のパターニング方法に係り、より詳しくは、インクジェット方式により膜をパターニングするパターニング装置及びそれを用いた膜のパターニング方法に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

近年、ノズルから液体を噴射することにより、基板上に配線パターンを形成するインクジェット方式のパターニング装置が提案されている。インクジェット法を使用することにより、めっきやフォトリソグラフィなどを使用する方法に比べて極めて短手番で配線パターンを形成することができる。

【 0 0 0 3 】

このようなパターニング装置では、液体としてアルコール系の溶媒に Cu や Au などの金属粒子を分散させたものが使用される。そして、液体供給部から搬送された液体をノズルから噴射させることにより、基板上の所要部分に液体が塗布され、溶媒が蒸発することで金属粒子から構成される配線パターンが得られる。

【 0 0 0 4 】

特許文献 1 には、回路基板の金属膜を形成する際に、めっきやフォトリソグラフィを使用する代わりに、インクジェット法による吹き付けを使用してもよいことが記載されている。

【 0 0 0 5 】

【特許文献 1】

特開 2 0 0 1 - 2 1 2 0 6 4 6 号公報 段落番号【 0 0 8 2】及び【 0 1 4 1】

【 0 0 0 6 】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記したような金属粒子が分散された液体を使用する場合、基板上に塗布された液体の溶媒が蒸発して金属粒子が残るものの、金属粒子は基板上に付着するだけで密着強度が低いため、信頼性の高い配線パターンが得られないという問題がある。

【 0 0 0 7 】

このため、インクジェット法により下地との密着性が高い配線パターンを形成する技術が切望されている。

【 0 0 0 8 】

なお、特許文献 1 には、インクジェット法を使用して配線パターンを形成する際に、下地との密着性が低い問題に関しては何ら考慮されていない。

【 0 0 0 9 】

本発明は以上の課題を鑑みて創作されたものであり、インクジェット法により下地との密着性が高い配線パターンを安定して形成できるパターンニング装置及び膜のパターンニング方法を提供することを目的とする。

【 0 0 1 0 】

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するため、本発明はパターンニング装置に係り、基板が載置されるステージと、紫外線に反応して金属が析出する液体を前記基板上に塗布する塗布手段と、前記基板上に塗布される前記液体に紫外線を照射する紫外線照射手段

とを有することを特徴とする。

【 0 0 1 1 】

本発明のパターニング装置では、ステージ上に基板が載置され、インクジェット方式に基づく塗布手段により基板上に金属錯体（金錯体、銅錯体など）を含む液体が塗布される。そして、基板上に塗布された液体に紫外線照射手段により紫外線（好適には波長が 1 0 0 ～ 3 0 0 n m）が照射される。これにより、液体内の金属イオンが還元されて金属が析出することによって金属膜パターンが形成される。

【 0 0 1 2 】

このように、本発明のパターニング装置では、液体内の金属イオンが紫外線照射により基板上に金属となって順次析出することで金属膜パターンが形成されるようにしたので、金属膜パターンが基板に対して密着強度が高い状態で形成されるようになる。

【 0 0 1 3 】

また、インクジェット法により金属膜パターンが直接描画されて形成されるので、めっきやフォトリソグラフィなどを用いて金属膜パターンを形成する方法より、製造装置が簡易となり、かつ製造工程が短手番となるので、製造コストを低減させることができる。

【 0 0 1 4 】

また、基板上の金属膜パターンが形成される部分のみに液体を塗布すればよいので、フォトリソグラフィなどを使用する場合と違って、材料を無駄にすることなく金属膜パターンを形成できるという点でも製造コストを低減することができる。

【 0 0 1 5 】

さらには、液体の種類や塗布条件を変えることなく、紫外線の照射量により液体内の金属の析出量を制御できるので、煩雑な作業を伴わずに金属膜パターンの膜厚を調整することができる。

【 0 0 1 6 】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について、添付の図面を参照して説明する。

【0 0 1 7】

図 1 は本発明の実施形態のパターニング装置を示す模式図、図 2 及び図 3 は本発明の実施形態のパターニング装置に係る塗布手段を示す断面図、図 4 及び図 5 は本発明の実施形態の膜のパターニング方法を示す断面図である。

【0 0 1 8】

図 1 に示すように、本実施形態のパターニング装置 1 は、基板 2 が載置されるステージ 1 0 を備えており、このステージ 1 0 はそれを移動するためのステージ移動手段 1 2 に接続されている。ステージ移動手段 1 2 はステージ 1 0 を所定位置に移動させるサーボ機構とそれを動かすサーボモータにより構成される。これにより、ステージ 1 0 は X - Y 方向を含む水平方向の任意の位置に移動できるようになっている。

【0 0 1 9】

基板 2 は真空チャックなどのチャック手段（不図示）よりステージ 1 0 上に固定される。また、ステージ 1 0 には基板 2 を加熱するためのヒーターなどの加熱手段 1 1 が設けられており、基板 2 を例えば 1 0 0 ～ 2 0 0 ℃に加熱することができる。

【0 0 2 0】

ステージ 1 0 の上方には、基板 2 上にノズルから液体 3 を噴射して塗布するインクジェット方式の塗布手段 1 4 が配置されていて、塗布手段 1 4 は配管 1 6 を介して液体供給部 1 8 に繋がっている。また、塗布手段 1 4 にはノズル制御手段 1 5 が接続されており、塗布手段 1 4 のノズルの選定や噴射特性などを制御することができる。

【0 0 2 1】

さらに、紫外線を照射するためのファイバ 2 2 b が基板 2 の近傍まで延びて配置されており、ファイバ 2 2 b は UV ランプ 2 2 b に接続されている。UV ランプ 2 2 a 及びファイバ 2 2 b が紫外線照射手段 2 2 を構成している。UV ランプ 2 2 a は 1 0 0 ～ 3 0 0 nm の波長の紫外線を放出し、ファイバ 2 2 b を介して基板 3 上に塗布された液体 3 に紫外線を照射できるようになっている。また、U

Vランプ 2 2 a は紫外線の照射強度をコントロールできようになっている。

【 0 0 2 2 】

本実施形態に係る液体 3 は溶媒に金属錯体が溶解されたものであり、紫外線を照射することにより金属が基板 2 上に析出する特性を有する。そのような液体 3 の詳しい説明は後述する膜のパターニング方法の欄で説明する。

【 0 0 2 3 】

さらに、パターニング装置 1 はコントローラ 2 4 を備えており、このコントローラ 2 4 はステージ移動手段 1 2、加熱手段 1 1、紫外線照射手段 2 2、液体供給部 1 8 及びノズル制御部 1 5 に接続されている。これにより、基板 2 の液体 3 が塗布される部分の位置決め、塗布手段 1 4 からの液体 3 の噴出特性、紫外線の照射量及び照射タイミングなどがコントローラ 2 4 により制御される。

【 0 0 2 4 】

上記した塗布手段 1 4 の構成には、液体 3 を噴射させる方式によって幾つかの種類が有る。図 2 (a) 及び (b) には、バブルジェット方式の塗布手段 1 4 が例示されている。図 2 (a) はノズル 1 4 x 内に液体 3 が充填されている状態を示しており、図 2 (b) に示すように、ノズル 1 4 x に設けられた発熱体 1 4 y を発熱させると液体 3 内に気泡 1 7 が発生し、この気泡 1 7 によって液体 3 がノズル 1 4 x の先端から押し出されて外部に噴出する。

【 0 0 2 5 】

また、図 3 (a) 及び (b) には、ピエゾ駆動方式の塗布手段 1 4 が例示されている。図 3 (a) に示すように、ノズル 1 4 x にはピエゾ抵抗効果に基づいてひずみを発生させる圧電変換素子 (ピエゾ素子) 1 4 z が設けられており、圧電変換素子 1 4 z に電圧を印加すると、圧電変換素子 1 4 z がへこみノズル 1 4 x 内に液体 3 が注入される。そして、図 3 (b) に示すように、圧電変換素子 1 4 z に印加する電圧を変化させることにより、圧電変換素子 1 4 y が逆に膨らんで液体 3 がノズル 1 4 x の先端から押し出されて外部に噴出する。

【 0 0 2 6 】

あるいは、ノズル 1 4 x に設けられた超音波振動子の動作によって液体 3 をノズル 1 4 x から噴射するようにしてもよい。

【 0 0 2 7 】

塗布手段 1 4 のノズル 1 4 x の口径や数は特に限定されないが、例えば、配線基板の配線パターンを形成する場合、ノズル 1 4 x の先端口径は $30 \sim 80 \mu\text{m}$ (好適には $50 \mu\text{m}$ 程度) であり、その数は $30 \sim 90$ 個 (好適には 60 個程度) ある。これによって、金属膜パターンの幅、膜厚及びトータル面積などが変化する場合であっても容易に対応できるようになっている。そして、ノズル制御手段 1 5 により液体 3 を噴出させるノズル 1 4 x が選択されると共に、液体 3 の噴出量及び噴出タイミングなどが制御される。

【 0 0 2 8 】

本実施形態のパターニング装置 1 はこのような構成になっており、ステージ移動手段 1 2 により基板 2 が載置されたステージ 1 0 を水平方向に移動させながら、基板 3 上の任意の部分に塗布手段 1 4 により液体 3 を噴出して塗布することができる。そして、基板 2 上に液体 3 を塗布しながら又は塗布した後に、基板 2 上の液体 3 に紫外線照射手段 2 2 により紫外線を照射することができる。これによって、後述するように、液体 3 内の金属イオンが還元されて基板 3 上に金属となって析出することにより基板 2 上に密着強度が高い金属膜パターンが形成される。

【 0 0 2 9 】

次に、前述したパターニング装置 1 を用いた膜のパターニング方法について説明する。まず、前述したパターニング装置 1 のステージ 1 0 上に基板 2 を載置した後に、チャック手段により基板 2 を固定する。このとき、ステージ 1 0 の加熱手段 1 1 を ON にしておき、基板 3 の温度が $100 \sim 200^\circ\text{C}$ になるようにする。

【 0 0 3 0 】

その後に、図 4 (a) 及び (b) に示すように、ステージ 1 0 を水平方向に移動させながら又は固定した状態で、基板 2 上の金属膜パターンが形成される部分に塗布手段 1 4 により液体 3 を塗布して液体塗布層 3 a を形成する。続いて、UV ランプ 2 2 a から放出される紫外線をファイバ 2 2 b の先端から基板 2 上の液体塗布層 3 a に照射する。このとき、液体 3 を塗布しながら随時基板 2 上の液体

塗布層 3 a に紫外線を照射するようにしてもよい。UV ランプ 2 2 a としては、波長が 3 0 0 nm 程度以下のものが使用され、特に波長が 1 7 2 nm のエキシマー UV ランプが好適に使用される。

【0 0 3 1】

本実施形態で使用される液体 3 としては、金属錯体の一例である $\text{K Au}(\text{CN})_2$ (金錯体) を溶媒に溶解させたものが使用される。あるいは、金属錯体として、銅 (Cu) 錯体、パラジウム (Pd) 錯体又はニッケル (Ni) 錯体などを使用してもよい。銅錯体としては、 Cu-EDTA (エチレンジアミン 4 酢酸) などがある。また、パラジウム錯体としては、紫外線感光性化合物 (パラジウム合金)、又はパラジウム有機錯体 (Pd-EDTA 、 Pd-アミン錯体 、 Pd-PVA (ポリビニルアルコール)、 Pd-キレート化合物 、ジチオシュウ酸パラジウム、パラジウムカルボン酸塩) などがある。

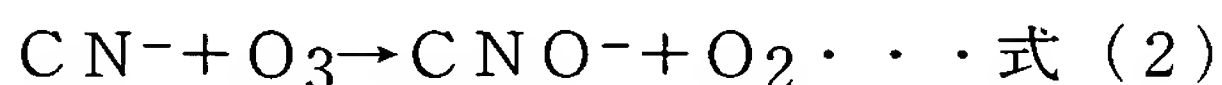
【0 0 3 2】

これらの金属錯体を溶解する溶媒としては、水、 KOH 水溶液、又は水とエタノール (表面張力をコントロールする) との混合液などが使用される。

【0 0 3 3】

例えば、 $\text{K Au}(\text{CN})_2$ が溶解された液体 3 が基板 2 上に塗布された液体塗布層 3 a に紫外線を照射すると、まず、式 (1) に示すように、空気中の酸素が紫外線のエネルギー ($h\nu$) を受けてオゾン (O_3) が発生する。次いで、式 (2) に示すように、この O_3 と液体塗布層 3 a 中の CN^- イオンとが反応して CNO^- 及び O_2 が発生する。さらに、式 (3) に示すように、 CNO^- が O_3 及び H_2O と反応して HCO_3^- 、窒素 (N_2) 及び酸素 (O_2) に分解される。なお、 CN^- イオンは、紫外線によっても直接分解される。

【0 0 3 4】



このように、液体塗布層 3 a に紫外線を照射することにより、液体塗布層 3 a 中の CN^- イオンが酸化反応により分解する。

【 0 0 3 5 】

このとき、液体塗布層 3 a 中の $Au(CN)_2^-$ イオンも分解する。これにより、図 5 (a) に示すように、基板 2 上に Au_2S_5 が順次析出していく。またこのとき、基板 2 は $100 \sim 200^\circ C$ 程度に加熱されているので、上記した反応が促進されると共に、 Au の析出が終了した後には液体塗布層 3 a の溶媒が蒸発するようになっている。

【 0 0 3 6 】

これにより、図 5 (b) に示すように、析出した Au_2S_5 より構成される金属膜パターン 2 6 が形成される。

【 0 0 3 7 】

前述したような紫外線に反応して金属が析出するような各種金属錯体が溶解された液体を使用することにより、金膜の他に各種の金属膜パターン (Cu 膜、 Pd 膜、又は Ni 膜など) を形成することが可能である。 Pd 錯体が溶解された液体を使用する場合、無電解めっきの触媒としての Pd 核の形成に有効である。

【 0 0 3 8 】

このとき、液体塗布層 3 a に照射する紫外線の量を調整することにより、析出する Au_2S_5 の量を制御することができるので、液体 3 の仕様や塗布条件を変えることなく、容易に金属膜パターン 2 6 の膜厚を調整することができる。

【 0 0 3 9 】

このように、金属錯体が溶解した液体塗布層 3 a に紫外線を照射することにより、基板 2 上に金属を順次析出させて金属膜パターン 2 6 を形成するようにしたので、金属膜パターン 2 6 が基板 2 上に密着強度の高い状態で形成される。また、めっきやフォトリソグラフィなどを用いて金属膜パターンを形成する方法より、製造装置が簡易となり、かつ製造工程が短手番となるので、製造コストを低減させることができる。

【 0 0 4 0 】

また、基板 2 上の金属膜パターン 2 6 が形成される部分のみに液体 3 を塗布すればよいので、フォトリソグラフィなどを使用する場合と違って、材料を無駄にすることなく金属膜パターン 2 6 を形成できるという観点からも製造コストを低

減することができる。

【0 0 4 1】

なお、従来のインクジェット方式のパターニング装置では、金属粒子が分散された液体の溶媒を蒸発させて金属粒子を基板上に残すことで金属膜パターンを形成するので、金属膜パターンの膜厚を変化させる場合、液体の種類（金属粒子の含有量など）や塗布条件を変える必要があり、作業が煩雑になる。

【0 0 4 2】

しかしながら、本実施形態では、液体 3 の種類や塗布条件を変えることなく、紫外線の照射量により液体塗布層 3 a に含まれる金属の析出量を制御できるので、煩雑な作業を伴わずに金属膜パターン 2 6 の膜厚を調整することができ、作業効率を向上させることができる。

【0 0 4 3】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明のパターニング装置では、ステージ上に基板が載置され、インクジェット法による塗布手段により、紫外線と反応して金属が析出する液体が基板上に塗布される。そして、基板上の液体塗布層に紫外線照射手段で紫外線を照射することにより、液体塗布層内の金属イオンが還元されて金属となって基板上に析出して金属膜パターンが形成される。

【0 0 4 4】

これにより、金属膜パターンが密着強度の高い状態で基板に形成される。また、インクジェット法により金属膜パターンが直接描画されて形成されるので、製造工程が短手番となり、製造コストを低減させることができる。さらに、紫外線の照射量により液体塗布層の金属析出量を制御できるので、煩雑な作業を伴わずに金属膜パターンの膜厚を調整することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

図 1 は本発明の実施形態のパターニング装置を示す模式図である。

【図 2】

図 2 は本発明の実施形態のパターニング装置に係る塗布手段（バブルジェット

方式) を示す断面図である。

【図 3】

図 3 は本発明の実施形態のパターニング装置に係る塗布手段（ピエゾ駆動方式）を示す断面図である。

【図 4】

図 4 は本発明の実施形態の膜のパターニング方法を示す断面図（その 1）である。

【図 5】

図 5 は本発明の実施形態の膜のパターニング方法を示す断面図（その 2）である。

【符号の説明】

- 1 …パターニング装置、
- 2 …基板、
- 3 …液体、
- 3 a …液体塗布層、
- 1 0 …ステージ、
- 1 1 …加熱手段、
- 1 2 …ステージ移動手段、
- 1 4 …塗布手段、
- 1 4 x …ノズル、
- 1 4 y …発熱体、
- 1 4 z …圧電変換素子、
- 1 5 …ノズル制御手段、
- 1 6 …配管、
- 1 7 …気泡、
- 1 8 …液体供給部、
- 2 2 …紫外線照射手段、
- 2 2 a …UV ランプ、
- 2 2 b …ファイバ、

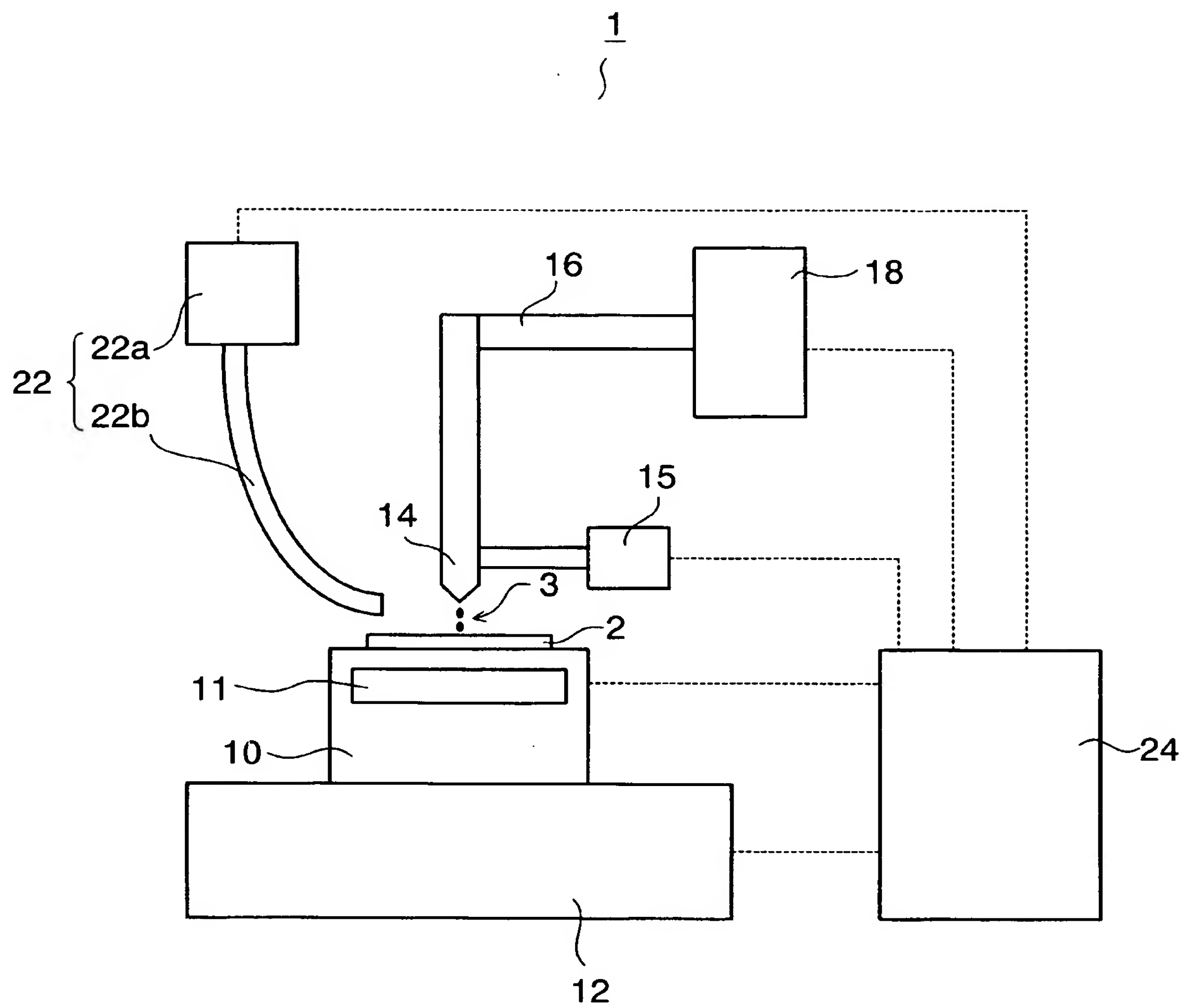
2 4 …コントローラ、

2 5 …金、

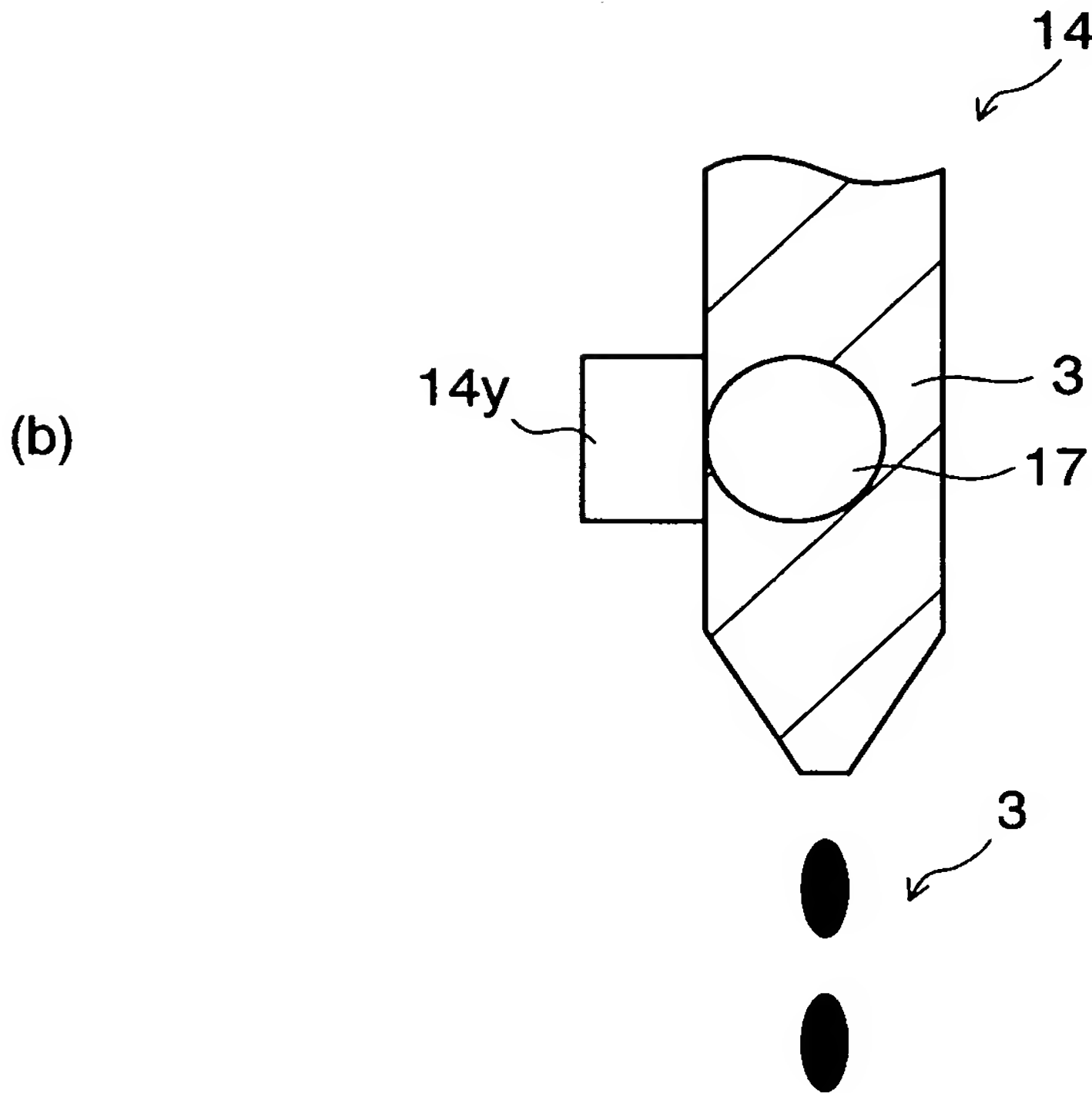
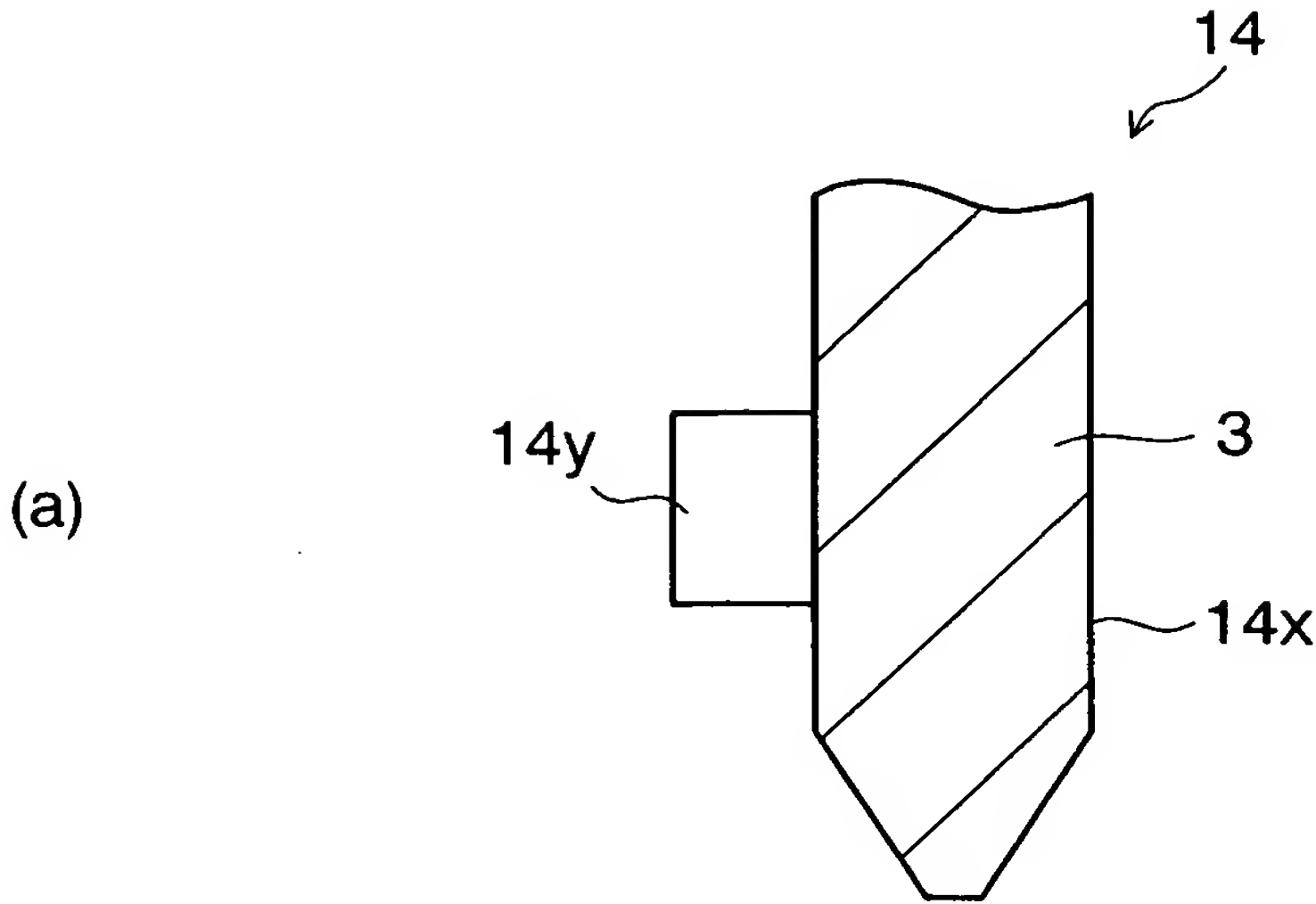
2 6 …金属膜パターン。

【書類名】 図面

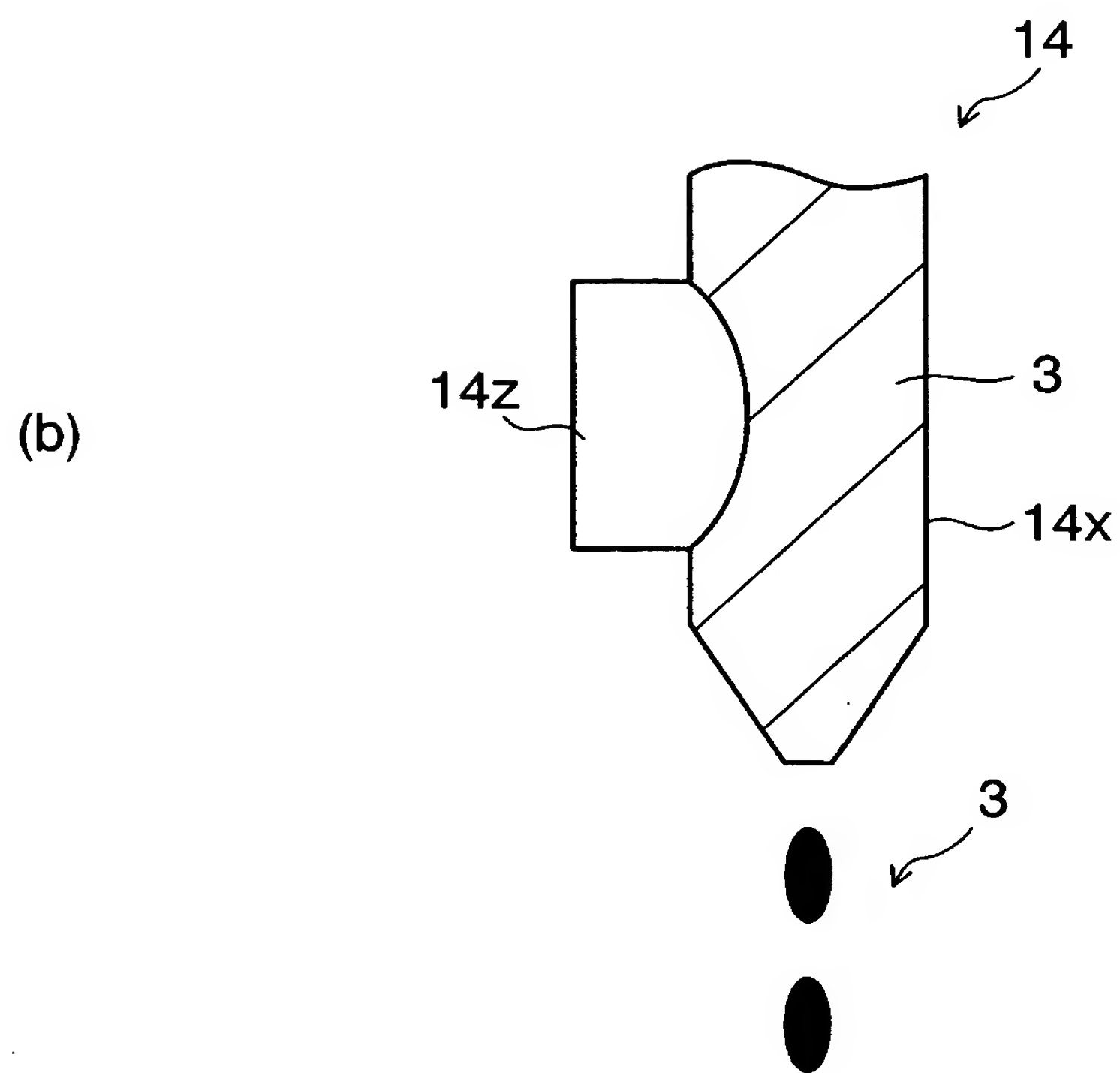
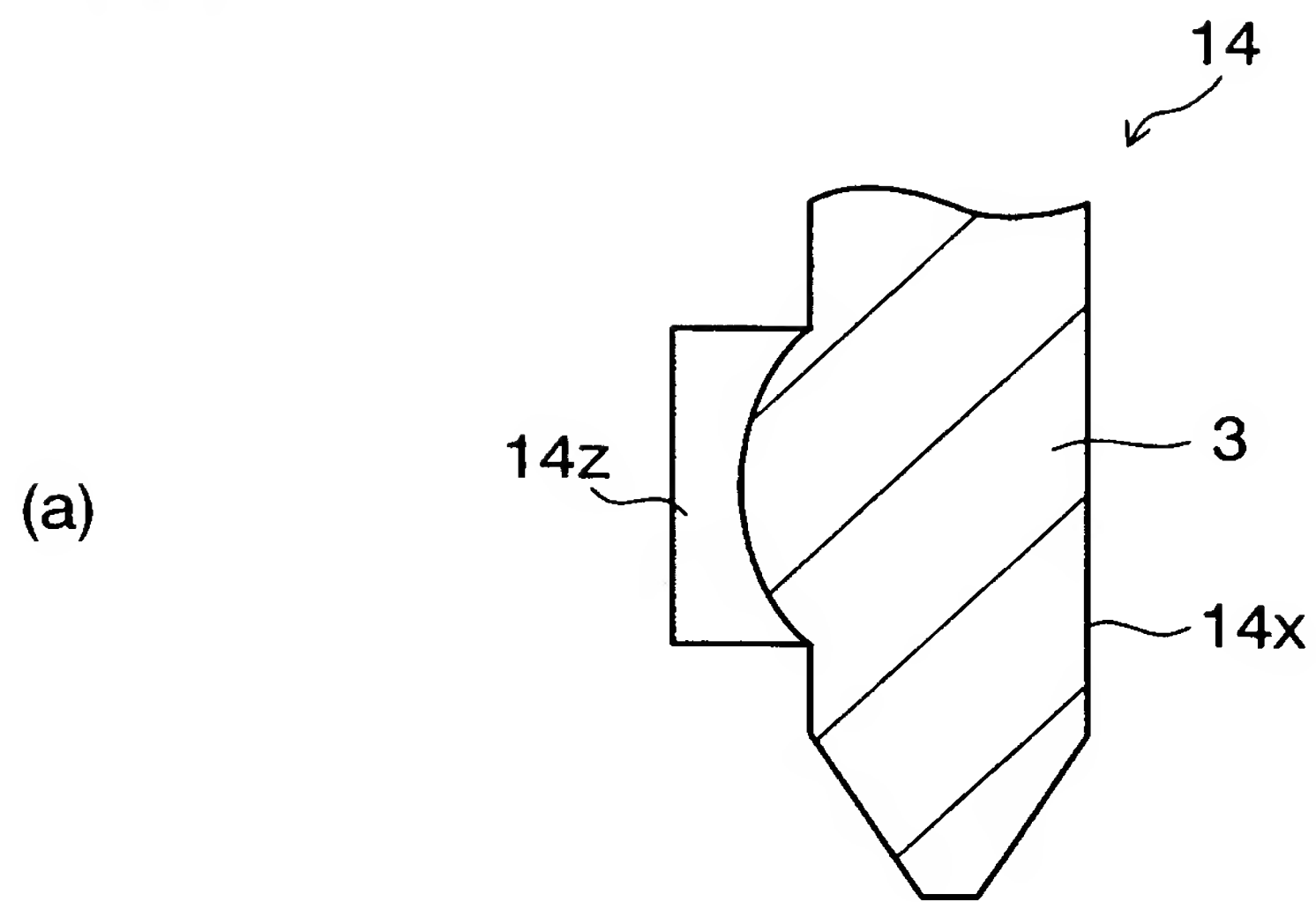
【図 1】



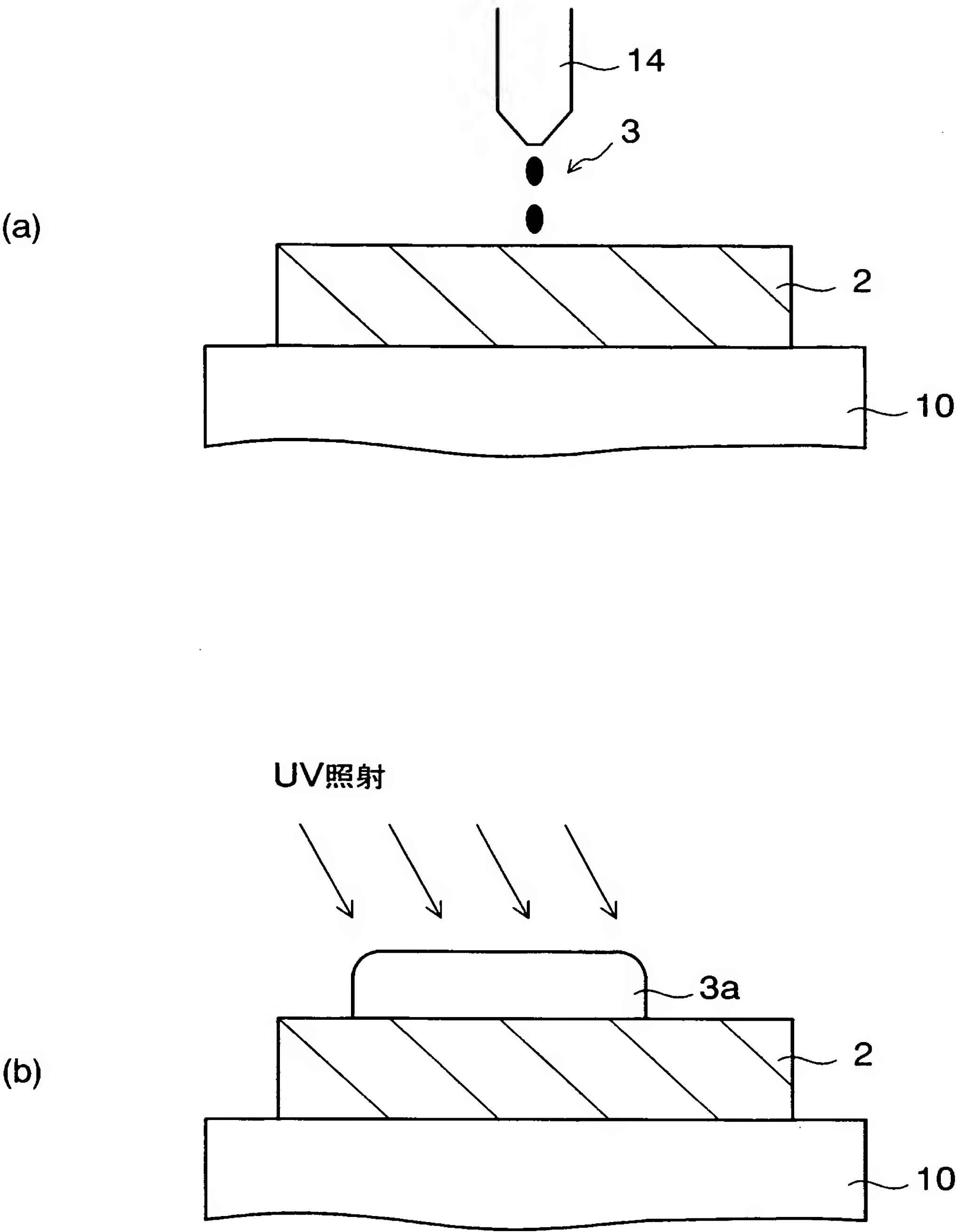
【図 2】



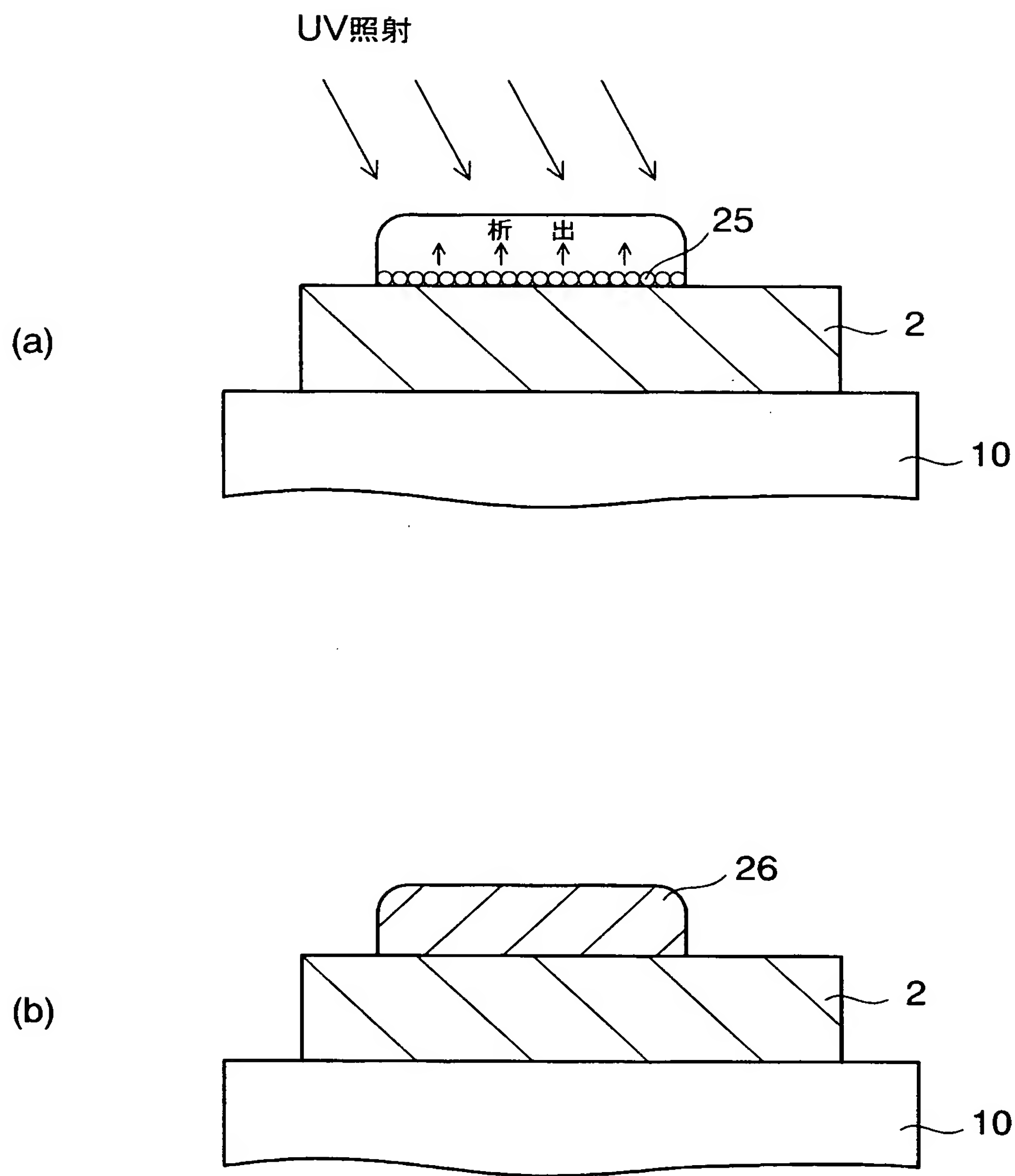
【図 3】



【図 4】



【図 5】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 インクジェット法により下地との密着性が高い配線パターンを安定して形成できるパターンニング装置を提供する。

【解決手段】 基板 2 が載置されるステージ 1 0 と、紫外線と反応して金属が析出する液体 3 を基板 2 上に塗布する塗布手段 1 4 と、基板 2 上に塗布される液体 3 に紫外線を照射する紫外線照射手段 2 2 とを含む。

【選択図】 図 1

特願 2 0 0 3 - 1 1 5 2 4 0

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 1 9 0 6 8 8]

1. 変更年月日 1 9 9 0 年 8 月 2 0 日
[変更理由] 新規登録
住 所 長野県長野市大字栗田字舎利田 7 1 1 番地
氏 名 新光電気工業株式会社
2. 変更年月日 2 0 0 3 年 1 0 月 1 日
[変更理由] 住所変更
住 所 長野県長野市小島田町 8 0 番地
氏 名 新光電気工業株式会社